

HJSIP®

HJ-568IMH_硬件设计手册

基于 OnMicro 昂瑞微 OM6626

8.5*9.2*2.2mm

板载/陶瓷/外接天线

BLE6.1 无线传输模组

版本：V1.7

日期：2026/08/13

版本:	V1.7
日期:	2026/08/13
状态:	已发布

前言

感谢使用 HJSIP 提供的蓝牙模组。HJ-568IMH 系列标准蓝牙模组，是一款基于昂瑞微 OM6626 高性能低功耗物联网蓝牙收发器。模组采用邮票口封装，支持板载/陶瓷/外接天线，具有功耗低、体积小、抗干扰能力强等特点，适用于多种应用场景。

此模组主要用于数据通讯，本公司不承担由于用户不正当操作造成的财产损失或者人身伤害责任。请用户按照手册中的技术规格和参考设计开发相应的产品。同时注意使用移动产品应该关注的一般安全事项。

在未声明之前，本公司有权根据技术发展的需要对本手册内容进行修改。

版权声明

本手册版权属于 HJSIP，任何人未经我公司书面同意复制、引用或者修改本手册都将承担法律责任。

目录

版本历史	3
适用模组选型	5
1 绪论	6
2 产品综述	6
2.1 关键特性	6
2.2 应用场景	7
2.3 功能框图	7
2.4 引脚分布图	7
2.5 引脚描述表	7
3 射频特性	9
3.1 天线接口和工作频段	9
3.2 BLE 射频性能	9
4 电气性能可靠性	9
4.1 最大耐受值	9
4.2 直流特性	9
5 硬件设计注意事项	10
6 天线	11
7 机械尺寸	12
8 贴片生产	12
8.1 超声波焊接注意事项	12
8.2 回流焊作业指导	12
8.3 湿敏特性	13
9 包装	13
9.1 包装方式	13
9.2 标签信息	14
10 认证	15
10.1 FCC 认证 (USA)	15
10.2 TELEC 认证 (JAPAN)	16
10.3 CE 认证 (Europe)	17
10.4 BQB 认证 (China)	18

联系方式

唐山宏佳电子科技有限公司

地址:河北省唐山市路南区女织寨镇正泰里春晓 b46 商铺 4 幢 1 单元 203 号(春晓 1 期 204 栋对面 6 层楼)

技术支持: liyinfei@tshjdz.com 或 liujiahang@tshjdz.com

版本历史

版本	日期	变更描述	修订人	审核人
V1.0	2025/03/28	第一版	WYW	LMY
V1.1	2025/08/19	1) 由 BLE5.4 变更为 BLE6.1; 2) 表 2-2: RST 引脚增加复位时长说明, 增加连接说明; 3) 6 机械尺寸: 模组尺寸由 8.5*9 改为 8.5*9.2mm; 4) 天线类型变更: 由板载天线改为: 板载/陶瓷/外接。	WYW	LMY
V1.2	2025/10/28	1) 6 机械尺寸: 增加板厚和误差; 2) 增加产品图片。	WYW	LMY
V1.3	2025/12/15	1) 表 2-2: 更改 PIN1 名称, RST/GPIO 变更为 RST/P13; 2) 表 8-1: 增加每盘包装数量信息。	WYW	LMY
V1.5	2026/05/09	增加外接天线章节	WYW	LMY
V1.6	2026/06/26	增加联系方式	WYW	LMY
V1.7	2026/08/13	表 2-2: 删除 P16 引脚功能	WYW	LMY

适用模组选型

序号	模组型号	类型	描述
1	HJ-568IMH_SPPv2	串口透传标准版	内置串口透传固件，该固件模组是蓝牙设备或者手机与 MCU 之间双向通信的桥梁，使用者不需要了解蓝牙协议栈，通过串口指令操作和串口数据收发即可，操作简单，缩短用户开发周期，加快产品上市。
2	HJ-568IMH_CUSv2	客户定制版	该版本支持客户定制固件，客户根据产品需求提出功能，我们会定制出专用版本固件的模组为客户供货。
3	HJ-568IMH_DEV	客户开发版	提供标准 SDK, 方便客户进行 OPEN CPU 二次开发

1 绪论

HJ-568IMH 系列标准蓝牙模组，是一款高性能物联网蓝牙收发器。模组采用邮票口封装，支持板载/陶瓷/外接天线。产品还具有功耗低、体积小、抗干扰能力强等特点，适用于多种应用场景。



图 1.1：产品图片

2 产品综述

2.1 关键特性

表 2-1：HJ-568IMH 关键特性

特性	说明
功能	- 支持 BLE 6.1、嵌入低功耗蓝牙协议栈和 GATT 服务 - 支持 BLE 主从一体（支持最多 20 个连接, 支持主从同时工作，互不影响） - 支持数据透传，或无程序模组可供客户自行开发固件
工作电压	1.71V ~ 3.6V
射频特性	- 工作频率 2.4GHz，支持 ISM 免费频段 - 发射功率：-30dBm ~ +8dBm - 高接收灵敏度：-98dBm@1Mbps -95dBm@2Mbps - TX 峰值电流<4mA@0 dBm RX 峰值电流<3mA@1Mbps - 板载/陶瓷天线在开阔地区的无线传输距离：30~100 米
模组尺寸	8.5*9.2*2.2mm
封装	邮票口封装，焊盘间距 0.8mm 和 1mm
重量	0.16g
低功耗	- 休眠电流<0.8μA (No RAM retention, wake on by GPIO) - 休眠电流<1.2μA (16K RAM retention, wake on by RTC) - 1 秒间隔广播电流 9μA (0dBm) 或 12.5μA (+4dBm) - 2 秒间隔广播电流 4.8μA (0dBm)
工作温度	-40 ~ +85℃
存储温度	-40 ~ +85℃
GPIO 口	15 个（RST 引脚作为 GPIO 使用）
产品认证	BQB, FCC, CE, TELEC, ROHS

2.2 应用场景

- 2.4GHz 低功耗蓝牙系统；
- 智能家居、无线遥控；
- 运动、医疗保健等消费类电子产品；
- 工业监控；
- 智能交通等。

2.3 功能框图

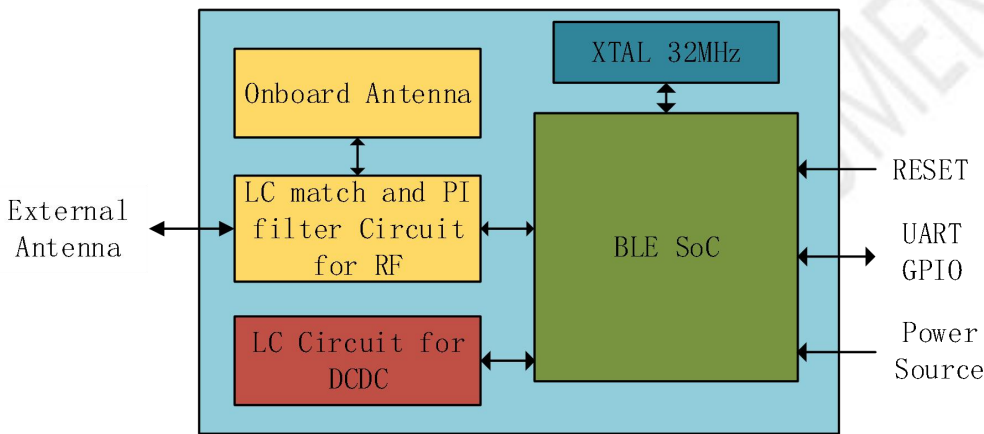


图 2.1：HJ-568IMH 功能框图

2.4 引脚分布图

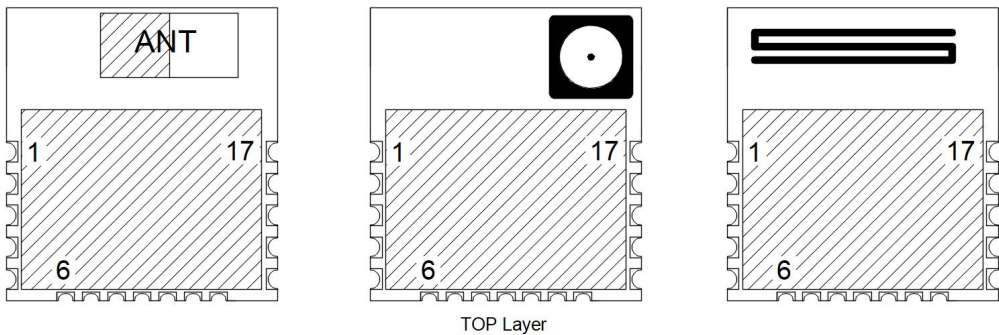


图 2.2：HJ-568IMH 引脚分布图（正面图）

2.5 引脚描述表

表 2-2：HJ-568IMH 引脚描述表

PIN	名称	类型	描述	备注
1	RST/P13	nReset /IO	低有效外部复位 复位时长>1s	可屏蔽复位功能,做普通 I0 使用; 做复位使用时连接到外部 I0, 若不连须加 1k

				强上拉。
2	P04	IO	通用输入输出口	可定制为其他功能
3	P21 (从机模式 连接状态 指示)	OUTPUT	从机连接状态指示	从机连接状态指示引脚 (当输出为高电平时, 模组作为从机已经成功被主机连接; 当输出为低电平时, 模组作为从机已经被主机断开连接。)
4	P01	IO	通用输入输出口	可定制为其他功能
5	P05	IO	通用输入输出口	可定制为其他功能
6	P10 (BLE-TX)	OUTPUT	UART-TX	蓝牙模块的串口 TX 引脚 (透传模式下, 该引脚为串口的 TX 引脚, 与 MCU 的 RX 连接)
7	P00	IO	通用输入输出口	可定制为其他功能
8	P09 (BLE-RX)	INPUT	UART-RX	蓝牙模块的串口 RX 引脚 (透传模式下, 该引脚为串口的 RX 引脚, 与 MCU 的 TX 连接)
9	P08 (UART RECEIVE ENABLE)	INPUT	串口接收使能引脚	串口接收使能引脚 当外部需要将串口数据发送给 BLE 模组时, 首先将该引脚从高电平 1 变为低电平 0, 串口接收使能, 变为低电平 0 至少 1ms 后再向串口发送数据。 (如果不考虑功耗, 可以将该引脚一直拉低 0), 发送完毕后将该引脚拉高 1 以节省功耗。
10	P02 (UART 流 控 RTS)	OUTPUT (UART RTS)	串口流控 RTS	BLE 串口流控 RTS 输出 (允许外部串口数据发送使能) 当使能流控后, RTS 引脚输出低电平 0 时, 则允许外部设备向蓝牙发送数据; 当 RTS 引脚输出高电平 1 时, 则表示蓝牙忙, 禁止外部设备向蓝牙发送数据;
11	P03 (APP_DAT A_IND)	OUTPUT	APP 接收数据指示	APP 接收数据指示引脚 模块收到主机或手机发送过来的数据后, 将首先拉高该引脚 T1 (ms) (T1 可以设置, 范围为 1~255ms, 默认 20ms) 后数据才会从串口输出。数据发送完毕后会自动变为低 0 电平。平时该引脚保持低电平代表空闲。此引脚用来作为长连接低功耗设备的唤醒标志。
12	P07 (UART 流 控 CTS)	INPUT (UART CTS)	串口流控 CTS	BLE 串口流控 CTS 输入 (允许 BLE 串口向外发送数据使能) 使能串口流控后, 当 CTS 被外部输入低电平 0 时, 蓝牙串口允许向外发送数据; 当 CTS 被外部输入高电平 1 时, 蓝牙串口停止向外发送数据。
13	GND	Power Ground	电源地引脚	/
14	VCC	Power In	电源输入引脚	电源输入 DC1.71V ~ 3.6V
15	P06	IO	通用输入输出口	可定制为其他功能
16	P22	IO	通用输入输出口	可定制为其他功能
17	P23 (主机模 式连接状 态指示)	OUTPUT	主机连接状态指示	主机连接状态指示引脚 (当输出为高电平时, 模组已经成功连接外部从机; 当输出为低电平时, 模组断开外部从机连接。)

3 射频特性

模组设置板载/陶瓷/外接天线。

3.1 天线接口和工作频段

模组天线接口特性阻抗 50 欧姆。

射频工作频段为 2.402~2.480GHz。

3.2 BLE 射频性能

表 3-1：BLE 射频性能

属性	值	备注
无线调制方式	GFSK	/
频率范围	2.402 ~ 2.480GHz	频宽：2MHz
频道数	40	/
空中速率	1Mbps、2Mbps	/
射频端口阻抗	50 Ω	/
发射功率	最大： +8dBm	/
发射电流	4mA (@0dBm, 1Mbps)； 15mA (@8dBm, 1Mbps)	/
接收电流	典型值： 3mA	1Mbps
接收灵敏度	-98dBm (@1Mbps) -95dBm (@2Mbps)	/
天线	板载/陶瓷/外接天线	/

4 电气性能可靠性

4.1 最大耐受值

表 4-1：最大耐受值

参数	最小值	最大值	单位
供电电压 VCC	1.7	3.7	V
I/O 口电压	0	VCC	V
工作温度	-40	+85	°C
储存温度	-40	+85	°C

4.2 直流特性

表 4-2：推荐工作值

参数	推荐最小值	典型值	推荐最大值	单位
供电电压 VCC	1.71	3.3	3.6	V
I/O 口电压	0	3.3	VCC	V
休眠工作电流	/	<2	/	μ A
最大工作电流	/	4.5	/	mA
工作温度	-40	+25	+85	°C

表 4-3: IO 口直流特性

IO 引脚	驱动能力	最小值	最大值	单位
输入低电平	/	0	0.4	V
输入高电平	/	1.8	VCC	V
输出低电平	5mA	0	0.6	V
输出高电平	5mA	1.8	VCC	V

表 4-4: 功耗

测试条件	典型值	单位
休眠模式	<2	μA
从机模式下 20ms 间隙广播	505	μA
从机模式下 1S 间隙广播	9	μA
从机模式下 20ms 连接间隙保持连接	138	μA
从机模式下 7.5ms 连接间隙保持连接	350	μA
主机模式下扫描	5.1	mA
主机模式下 20ms 连接间隙保持连接	150	μA

5 硬件设计注意事项

- 所有 IO 口均可引出使用。
- 模块不能放入金属材料的外壳中，若使用金属外壳须将天线引出。
- 电路板每层都整体覆铜接 GND，并确保覆铜面积足够大（天线部分除外），且良好接地。
- 安装此无线模块的产品，金属材料部件，如螺丝，电感等应尽量远离无线模块射频天线部分。
- 在无线模块天线上，尽量不放置其它元器件，以防止遮挡影响无线性能。
- 无线模块尽量放在主板的四周边上，天线部分靠近主板边或角，模块天线下面的主板 PCB 应用 keepout layer 层注释挖空，若无法挖空，则天线下面不允许敷铜或走线，否则会影响 RF 性能。
- 所有引脚请注意查看引脚图，与之相连的 IO 请注意 IO 模式和状态。
- 输入电源为非电池供电、市电电源降压供电时建议串联磁珠或电感滤波。

6 天线

以下表格为经测试并通过认证可用于 HJ-568IMH 的外部天线。

#	图片	型号	类型	增益	规格书	认证
1		HJ2400-XLJ261001WQ	External	3.04dBi	公司官网下载	FCC,CE,TELEC
2		HJ2400-BA261001TQ	External	2dBi	公司官网下载	FCC,CE,TELEC
3		HJ2400-FPC2075FSK	PCB	≤2.91dBi	公司官网下载	FCC,CE,TELEC

7 机械尺寸

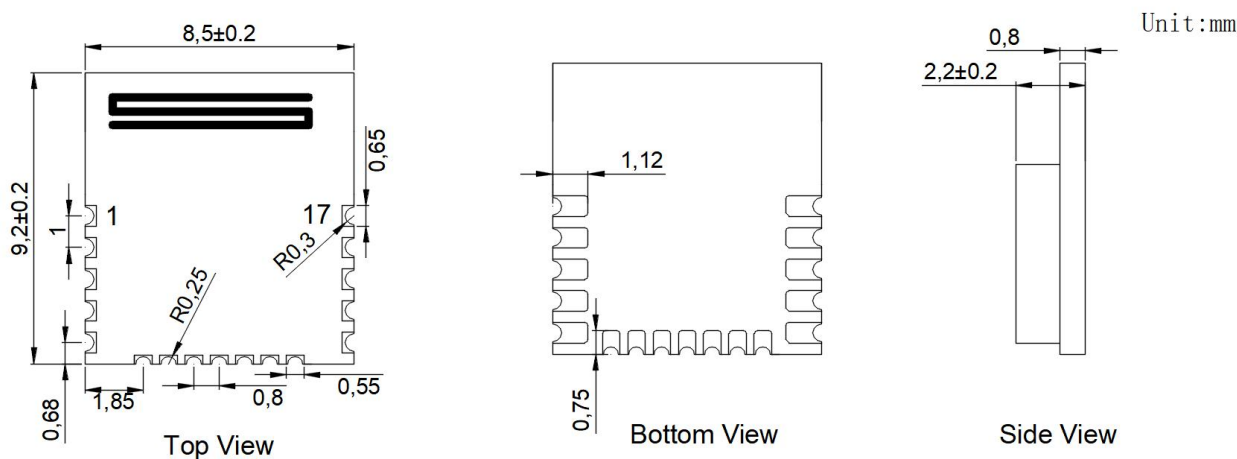


图 6. 1: HJ-568IMH 机械尺寸图

备注:
不同天线类型模组机械尺寸相同。

8 贴片生产

8. 1 超声波焊接注意事项

警告:
请慎重考虑使用超声波焊接工艺!
如果必须要使用超声波焊接工艺, 请使用 40KHz 高频率超声波焊接技术, 设计过程中请将模块远离超声波焊接线和固定柱, 以防止模块造成损伤!
具体超声波焊接事项, 请联系我司技术进行咨询。

8. 2 回流焊作业指导

HJ-568IMH 模组板材均为耐高温板材, 全部采用无铅工艺, 最高测试耐温为 265℃, 进行 10 次连续回流焊对性能和强度没有任何影响, 具体如下:

表 8-1: 回流焊参数

属性	值
特性参数	全无铅工艺
平均温度爬升率	3℃/秒 max
最低温度	150℃
最高温度	200℃
回流焊时间	80-100 秒
峰值温度	250±5℃
平均温度下调率	6℃/秒 max
温度从 25℃ 爬升到峰值温度时间	8 分钟 max

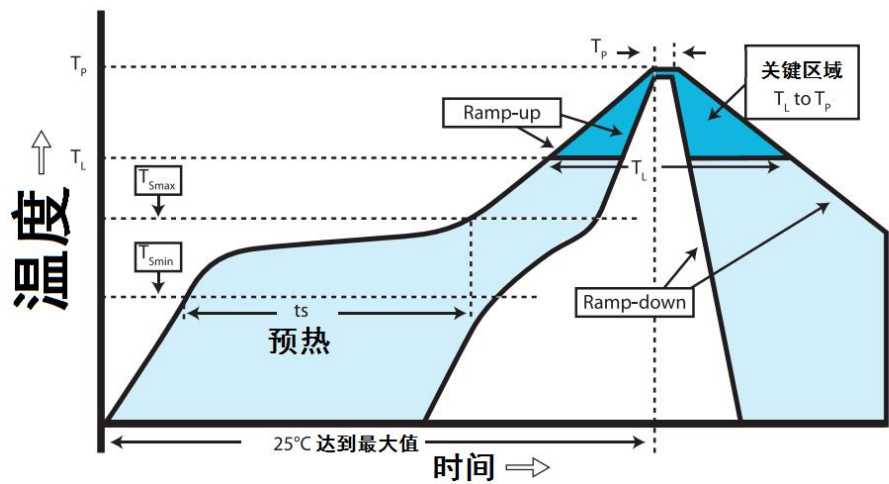


图 8. 1：回流焊温度曲线图

8. 3 湿敏特性

HJ-568IMH 模块的湿敏特性为 3 级。

如果满足如下二个条件的任何一条，HJ-568IMH 模组在进行回流焊前应该进行充分的烘烤，否则模块可能在回流焊过程中造成永久性的损坏。

- 拆封或真空包装破损漏气后，在温度<30 度和相对湿度<60%的环境条件下，模块需 168 小时内进行 SMT 贴片。如不满足上述条件需进行烘烤。
- 真空包装未拆封，但超过保质期的，也需要进行烘烤。

9 包装

9. 1 包装方式

表 9-1：包装方式

型号	包装方式	最小包装数量（PCS）
HJ-568IMH_XX	卷带	1500

编带包装后使用芯片级的防静电铝箔袋密封，每袋放入干燥剂，工业级抽真空机保证不漏气、防潮、防水防尘(IP65)。实际包装效果如图 8.1 所示。



图 9.1：产品包装图

9.2 标签信息

所有包装都用标签注明货物信息，ROHS 标识，防静电标识等。

【A】	唐山宏佳电子科技有限公司
【B】	HJ-XXX-XXX
【C】	Pb Free Reflow (260℃)
【D】	Date Code: 2508 HJ0218
【E】	注意：必须真空密封保存
【F】	警告：湿敏等级 MSL:XX
【G】	QTY: 1500PCS SEAL DATE: 20250218

图 9.2：产品标签图

表 9-2：模组信息描述

项次	描述
A	公司名称
B	产品型号
C	无铅回流焊标识及回流焊温度设定值
D	生产日期 例：2508 HJ0218 代表产品生产于 2025 年第 8 周，2 月 18 日
E	保存注意事项
F	湿敏等级
G	产品数量+销售日期

10 认证

10.1 FCC 认证 (USA)

TCB	GRANT OF EQUIPMENT AUTHORIZATION Certification Issued Under the Authority of the Federal Communications Commission By: DERYCOM CERTIFICATION SERVICES, INC. 1100 Falcon Avenue Glencoe, MN 55336	TCB										
		Date of Grant: 05/08/2026 Application Dated: 05/08/2026										
Tangshan HongJia electronic technology co., LTD. 352 No. 2 # building power springs in Qianxi County, Tangshan City, Hebei Provin Tangshan, China Attention: Liu Ying ,												
NOT TRANSFERABLE EQUIPMENT AUTHORIZATION is hereby issued to the named GRANTEE, and is VALID ONLY for the equipment identified hereon for use under the Commission's Rules and Regulations listed below.												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">FCC IDENTIFIER:</td> <td>2AGPM-HJ568IMH</td> </tr> <tr> <td>Name of Grantee:</td> <td>Tangshan HongJia electronic technology co., LTD.</td> </tr> <tr> <td>Equipment Class:</td> <td>Digital Transmission System</td> </tr> <tr> <td>Notes:</td> <td>Bluetooth(BLE 6.1) ultra-low power module with integrated antenna</td> </tr> <tr> <td>Modular Type:</td> <td>Single Modular</td> </tr> </table>			FCC IDENTIFIER:	2AGPM-HJ568IMH	Name of Grantee:	Tangshan HongJia electronic technology co., LTD.	Equipment Class:	Digital Transmission System	Notes:	Bluetooth(BLE 6.1) ultra-low power module with integrated antenna	Modular Type:	Single Modular
FCC IDENTIFIER:	2AGPM-HJ568IMH											
Name of Grantee:	Tangshan HongJia electronic technology co., LTD.											
Equipment Class:	Digital Transmission System											
Notes:	Bluetooth(BLE 6.1) ultra-low power module with integrated antenna											
Modular Type:	Single Modular											
<u>Grant Notes</u>	<u>FCC Rule Parts</u> 15C	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Frequency Range (MHZ)</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Output Watts</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Frequency Tolerance</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Emission Designator</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2402.0 - 2480.0</td> <td style="text-align: center;">0.0014</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<u>Frequency Range (MHZ)</u>	<u>Output Watts</u>	<u>Frequency Tolerance</u>	<u>Emission Designator</u>	2402.0 - 2480.0	0.0014				
<u>Frequency Range (MHZ)</u>	<u>Output Watts</u>	<u>Frequency Tolerance</u>	<u>Emission Designator</u>									
2402.0 - 2480.0	0.0014											
Single Modular Approval. Output power listed is conducted power. This device is equipped with five antennas: Option 1- RFANT3216120A5T Series; Option 2-Model: HJ-568IMH; Option 3-Model: HJ2400-FPC2075FSK; Option 4-Model: HJ2400-BA261001TQ; Option 5-Model: HJ2400-XLJ261001WQ. OEM integrators and end-users must be provided with transmitter operation conditions for satisfying RF exposure compliance. Only the antenna tested with the device or similar antennas with equal or lesser gain may be used with this transmitter.												

10.2 TELEC 认证 (JAPAN)

DERYCOM CERTIFICATION	Certificate Number: 222-260234 Rev. No. 01 Date of Issue: 08-05-2026
Japan Certificate of Construction Type	
Certificate Holder	
Tangshan HongJia electronic technology co., LTD. 352 No. 2 # building power springs in Qianxi County, Tangshan City, Hebei Provin, Tangshan, China	
Product Description	
Product Name: Bluetooth(BLE 6.1) ultra-low power module with integrated antenna	
Model Name: HJ-568IMH, HJ-565IMH, HJ-566IMH, HJ-567IMH, HJ-569IMH	
Brand Name: HJSIP®	
Hardware Version: V1.1	
Software Version: V2.1.1	
This Certificate remains valid as long as the stated product stays in compliance with essential requirements of the Japan Radio Act.	
	 Joe Chew, Product Certifier DERYCOM CERTIFICATION SERVICES, INC. 1100 Falcon Avenue Glencoe, MN 55336 USA Certification Body ID number: 222
DERYCOM CERTIFICATION SERVICES, INC. 1100 Falcon Avenue, Glencoe, MN 55336, USA Tel: +1 (320) 288-7687, Web: www.derycom-us.com	

Japan Certificate of Construction Type

F/CSD/19 Rev. No. 01

Page 1 / 3

10.3 CE 认证(Europe)



Tel: 86-755-3290 2199
E-mail: sztz@sztz-testing.com
Web: www.sztz-testing.com

Shenzhen Tongzhou Testing Co., Ltd.
Address: 1st Floor, Building 1, Haomal High-tech Park,
Huating Road 387, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, China

Verification of Conformity

Registration No. : TZ0032260207E0

Applicant : Tangshan HongJia electronic technology co., LTD.
352 No. 2 # building power springs in Qianxi, County, Tangshan City, Hebei
Provin, Tangshan, China

Product : Bluetooth(BLE 6.1) ultra-low power module with integrated antenna

Trademark : HJSIP™

Model(s) : HJ-568IMH, HJ-565IMH, HJ-566IMH, HJ-567IMH, HJ-569IMH

Manufacturer : Tangshan HongJia electronic technology co., LTD.
352 No. 2 # building power springs in Qianxi, County, Tangshan City, Hebei
Provin, Tangshan, China

Essential Requirement	Relevant Standards	Test Report No.	Result
Art.3.1(a) Health	EN 62479:2010, EN 50663:2017	TZ0032260207EHE01	Conform
Art.3.1(a) Safety	EN IEC 62368-1:2020 + A11: 2020	TZ0032260207ESA01	Conform
Art.3.1(b) EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09),	TZ0032260207ERF01	Conform
Art.3.2 Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	TZ0032260207ERF03	Conform

This Verification is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product. This Verification is issued on a voluntary basis according with the **RED Directive 2014/53/EU**. It confirms that the listed product complies with the principal protection requirements of the directive and is based on the technical specifications applicable at the time of issuance.

This Verification is part of the full test report(s) and should be used in conjunction with it <them>.




Signed by General Manager (Matte He)
Issue Date: March 30, 2026



This Verification does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC). After preparation of the necessary documentation and establishing compliance to requirements of all applicable directives, the manufacturer may sign a DoC and apply the CE marking.

10.4 BQB 认证 (China)

2025/9/9 14:16

Qualification Workspace - Qualified Product Details



(<https://www.bluetooth.com/>)

Qualification Workspace

Release Notes (<https://qualification.support.bluetooth.com/hc/en-us/articles/26985716085133-Qualification-Workspace-Release-Notes>) | [Ying Liu](#) | [Log Out](#)

Qualified Product Details

The details below should reflect how the Products are advertised, packaged, and distributed commercially.

☒ The submission has been approved.

Product List

Download Product and Design Details

Qualify additional Products

Product Name	Product Description	Model Number	Product Qualification Date	Product Publication Date	Internal Visibility	Product Website	Submitted By
HJSIP Bluetooth ultra-low power module with integrated antenna	Ultra low power Bluetooth module and onboard high-performance antenna	HJ-568IMH	2025-09-09	2025-09-09	Yes		Ying Liu
HJSIP Bluetooth ultra-low power module with integrated antenna	Ultra low power Bluetooth module and onboard high-performance antenna	HJ-565IMH	2025-09-09	2025-09-09	Yes		Ying Liu
HJSIP Bluetooth ultra-low power module with integrated antenna	Ultra low power Bluetooth module and onboard high-performance antenna	HJ-566IMH	2025-09-09	2025-09-09	Yes		Ying Liu
HJSIP Bluetooth ultra-low power module with integrated antenna	Ultra low power Bluetooth module and onboard high-performance antenna	HJ-567IMH	2025-09-09	2025-09-09	Yes		Ying Liu
HJSIP Bluetooth ultra-low power module with integrated antenna	Ultra low power Bluetooth module and onboard high-performance antenna	HJ-569IMH	2025-09-09	2025-09-09	Yes		Ying Liu

5 Product(s) found
Note: Only Products that have completed the Bluetooth Qualification Process will appear in the Qualified Product database search results on the specified Product Publication Date

Member Details

Member Company

Membership Status

Product Contact

Tangshan HongJia electronic technology co., LTD.

Active Member [Learn more \(https://support.bluetooth.com/hc/en-us/articles/4406833786381\)](https://support.bluetooth.com/hc/en-us/articles/4406833786381)

Ying Liu

Design Details

Create Subset

Reassess the Design

DN

Included Design(s)

Design Name

Core Configuration

Design Contact

Design available for other Members to use

Q371658

Q360481 (/ListingDetails/RedirectFromQdid/360481),
Q369252 (/ListingDetails/RedirectFromQdid/369252)

HJSIP Bluetooth ultra-low power module with integrated antenna

LE Core-Complete

Ying Liu

Yes

<https://qualification.bluetooth.com/ListingDetails/310423>

1/2

2025/9/9 14:16

Qualification Workspace - Qualified Product Details

Design available for other users within the same Member company to use

Yes

Supported Layers

View ICS Details

Export ICS

Included Design: Onmicro BLE Host - no CS

View ICS Details

QDID/DN

Q360481 (/ListingDetails/RedirectFromQdid/360481)

Company

Hongkong OnMicro Electronics Limited

Design Name

Onmicro BLE Host - no CS

Included Design: Onmicro BLE Controller – no CS

View ICS Details

QDID/DN

Q369252 (/ListingDetails/RedirectFromQdid/369252)

Company

Hongkong OnMicro Electronics Limited

Design Name

Onmicro BLE Controller – no CS

©2025 Bluetooth SIG, Inc. All rights reserved

Bluetooth Qualification Workspace Terms of Use (/MyProjects/ShowTOU) | Bluetooth.com (https://www.bluetooth.com) | Privacy Policy (https://www.bluetooth.com/about-us/privacy) | Help & Support (https://support.bluetooth.com/)

https://qualification.bluetooth.com/ListingDetails/310423

2/2